

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2111
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：牙體技術師

科 目：牙體技術學(二) (包括固定義齒技術學科目)

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關氧化鋯敘述，下列何者正確？
(A)彈性係數 (elastic modulus) 低，容易變形 (B)明度 (value) 低，不具透明性
(C)在光的折射率上與氧化鋁接近 (D)在光的透過性與氧化鋁接近
- 2 製作牙冠及牙橋補綴物所使用的印模材當中，下列何種印模材精密度相對較差？
(A)瓊膠 (agar) (B)藻膠 (alginate)
(C)矽膠 (silicone) (D)聚乙醚橡膠 (polyether)
- 3 當我們見到患者缺少右上頤第一小白齒及右上頤第一大臼齒，且患者希望進行右上頤之固定牙橋修復時：
Duchange 的指數可做為牙橋抵抗性判定，其指數判定公式為何？
(A) $r=R-(F+F \times S)$ R：欠缺齒的總合 F：支柱牙的總合 S：補足係數
(B) $r=R-(F+F \times S)$ R：欠缺齒的總合 F：支柱牙的總合 $F \times S$ ：補足係數
(C) $r=R-(F+F \times S)$ R：支柱牙的總合 F：欠缺齒的總合 $F \times S$ ：補足係數
(D) $r=R-(F+F \times S)$ R：支柱牙的總合 F：欠缺齒的總合 S：補足係數
- 4 承上題，關於 Duchange 指數的描述何者正確？
(A)右上頤第一小白齒的指數是 4，右上頤第一大臼齒的指數是 6
(B)右上頤第二大臼齒的指數是 6，右上頤犬齒的指數是 4
(C) $r > 0$ ：可作牙橋， $r \leq 0$ ：不可作牙橋
(D) $r < 0$ ：可作牙橋， $r \geq 0$ ：不可作牙橋
- 5 關於 VITA 3D-Master tooth guide 比色板敘述，下列何者錯誤？
(A)共分五個明度群
(B)明度最暗為 (群 5) (5M)，有 2 支色樣本齒
(C)共有 26 支各色樣本齒
(D)臨床比色時，先選擇明度群
- 6 有關氧化鋯從常溫至融點間結晶結構轉變敘述，下列何者最正確？
(A)常溫至 1170°C 為正方晶體 (B) $1170^{\circ}\text{C} \sim 2370^{\circ}\text{C}$ 為單斜晶體
(C) $1170^{\circ}\text{C} \sim 2370^{\circ}\text{C}$ 為立方晶體 (D) $2370^{\circ}\text{C} \sim$ 融點間為立方晶體
- 7 下列何種包埋方法能在最短等待時間內包埋鑄造固定義齒？
(A)雙重包埋法 (B)真空包埋法
(C)使用快速加熱型包埋材 (D)模型包埋法
- 8 鑄造完成的義齒須經過適當的調整才可交付醫師進行試戴，以下的調整過程何者錯誤？
(A)當義齒表面有明顯鑄造孔穴或明顯的鑄肌皺裂，應從蠟型開始重新製作
(B)義齒內部因包埋產生的小氣泡，可以用磨針慎重的除去
(C)牙齦下方的義齒邊緣部不足的情況，因在口內無法直接目視故可以用銲接修補
(D)義齒內冠面的修飾可用 $50\mu\text{m}$ 的氧化鋁噴砂處理

- 9 有關色彩三要素之敘述，下列何者錯誤？
(A)色彩的明、暗程度，稱為色彩的明度（value）
(B)顏色的濃度、強度，稱為色彩的彩度（chroma）
(C)黃、橘色屬於明度高之色彩
(D)白、黑、灰屬於彩度低之色彩
- 10 支柱牙模型的邊緣型態分類，下列何者具有肩台型？①刀緣型邊緣 ②羽毛型邊緣 ③弧形緣 ④斜面緣
(A)①②③④ (B)僅②③④ (C)僅③④ (D)僅①②
- 11 VITA 比色板 A1～A4 色相中，下列何者具有最高彩度（chroma）、最低明度（value）？
(A)A1 (B)A2 (C)A3 (D)A4
- 12 下列何者為陶瓷堆築前金屬表面噴砂處理之目的？①使金屬表面粗糙 ②增加陶瓷燒結面積 ③降低表面活性化作用 ④增加金屬表面潤濕性
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 13 下列各種瓷粉的透光程度，由低至高依次排列：①不透光瓷（opaque porcelain）②牙頸部瓷（cervical porcelain）③牙本質瓷（dentine porcelain）④半透明瓷（translucent porcelain）
(A)①②③④ (B)①③②④ (C)①③④② (D)①②④③
- 14 蠟型包埋前表面噴塗一層界面活性劑之目的，何者正確？①去除蠟型表面油脂 ②降低蠟型表面張力 ③增加蠟型表面張力 ④增加蠟型表面光滑
(A)①②④ (B)①③④ (C)僅①② (D)僅③④
- 15 下列材料熱膨脹係數由大而小依序排列，何者正確？①氧化鋁 ②氧化鋇 ③商業用純鈦 ④貴金屬合金
(A)④③②① (B)④②③① (C)④①②③ (D)④②①③
- 16 熔解合金時添加硼砂助熔劑之目的，下列何者正確？①降低合金熔點 ②增加合金流動性 ③防止合金表面氧化 ④去除氧化膜
(A)①③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④
- 17 下列針對鑄造環襯裡（liner for casting ring）置放的敘述，何者錯誤？
(A)鑄造後讓包埋材較容易移除
(B)可以吸收包埋材內部多餘水分
(C)提供包埋材加熱時膨脹所需空間
(D)石棉致癌疑慮，目前常改用陶纖維襯裡（ceramic-fiber lining）取代
- 18 目前牙科用電腦輔助設計與加工系統（CAD/CAM）無法全面普及化的最可能原因為下列何者？
(A)擔心保存製作物的數位資料個資外洩 (B)牙技師深怕未來全面自動化造成失業
(C)設備成本太高而且過程無法全面自動化 (D)電腦輔助設計與加工系統機種太多無從購買
- 19 請選出正確陶瓷融合金屬冠製作流程？①包埋與鑄造 ②鑲面部回切 ③牙冠形態築蠟 ④陶瓷堆築與烘烤 ⑤除氣（degassing） ⑥上釉（glazing）
(A)③②①④⑤⑥ (B)③②①⑤④⑥ (C)②①③⑤④⑥ (D)①②③④⑤⑥
- 20 上顎前牙區特別注重美學上的考量，近年來牙橋橋體（pontic）常以下列何種形態製作？
(A)馬鞍型 (B)船底型 (C)衛生型 (D)卵圓型
- 21 牙科瓷粉烘烤（燒成）過程中，下列那個階段的收縮量最大？
(A)低溫燒結 (B)中溫燒結 (C)高溫燒結 (D)最後烘烤
- 22 製作陶瓷融合金屬冠使用的合金當中，應盡量避免使用下列何種金屬成分，以防止影響合金的氧化程度？
(A)銀（Ag） (B)銅（Cu） (C)鐵（Fe） (D)鋅（Zn）

- 23 關於陶瓷融合金屬冠製作過程中，除氣（degassing）的主要目的，下列敘述何者錯誤？
 (A)除去鑄造應變（strain） (B)除去鑄造物表面髒污
 (C)形成的氧化膜會阻礙化學結合 (D)可以使鑄造體釋放出瓦斯防止多孔性發生
- 24 關於製作陶瓷融合金屬冠時，金屬鑄造過程中需要注意的事項，下列何者錯誤？
 (A)鑄造金屬過度加熱容易造成收縮性多孔（鑄巢）
 (B)合金的融解最好在其液相點再提高 50~150°C 為佳
 (C)合金融解時可加入硼砂助熔劑適度降低合金融點
 (D)包埋材加熱上昇至最高溫度通常須停留約 30 分鐘至 1 小時
- 25 牙科鉚劑若考量具備較好操作性與鉚接強度的條件時，選擇下列何種鉚劑最理想？
 (A)銀鐵 (B)銅鐵 (C)金銀鈮鐵 (D)14K~18K 金鐵
- 26 關於鉚接包埋過程，下列敘述何者錯誤？
 (A)包埋材硬化膨脹越小越好
 (B)包埋材加熱膨脹率最好稍高於鉚接母金
 (C)臨時固定材以氧化鋅丁香油酚印模材精密表現較優
 (D)包埋材加熱膨脹曲線須很平緩不可有太大的收縮膨脹
- 27 關於牙科鉚劑所應具備性質的敘述，下列何者錯誤？
 (A)鉚劑本身強度要好 (B)熔融時表面張力要小
 (C)與鉚接母金具類似成分 (D)融點比母金低 50~200°F
- 28 陶瓷金屬冠鉚接須注意燒結溫度，下列各項材質依燒結溫度由高至低排列，何者正確？①燒結陶瓷 ②燒結金屬 ③前鉚鉚材 ④後鉚鉚材
 (A)①②③④ (B)②①③④ (C)③①②④ (D)②③①④
- 29 有關於牙橋各構成要素的敘述，下列何者錯誤？
 (A)橋體可分衛生型、船底型、偏側型、嵴疊型、鞍型等等
 (B)連接體的剖面必須呈橢圓形，且要做到細緻光滑的研磨
 (C)橋體的選擇主要考慮美觀性
 (D)連接體的設計會影響到牙橋補綴治療的癒後
- 30 下列那些項目對固定義齒之製作與組織維護有關？①邊緣部的密合性 ②外型輪廓 ③表面粗糙程度 ④橋體組織面型態 ⑤楔隙和齒間乳頭的關係
 (A)僅①②③ (B)僅③④⑤ (C)僅①②④⑤ (D)①②③④⑤
- 31 有關固定義齒咬合力之描述，下列何者正確？
 (A)一般成年男性的第一大臼齒的最大咬合力平均 60~80kg
 (B)咀嚼力因食物的種類或咀嚼時期的不同，有時只有最大咬合力的 1/2~1/4 程度
 (C)咬合力會因個人差異、性別差異、年齡差異，但不會因牙周組織的健康狀態而有差異
 (D)一般成年男性的前牙部咬合力在 15~20kg
- 32 關於初診時採得的研究用模型跟技師作業的目的用途，下列敘述何者錯誤？
 (A)製作個別模托 (B)製作支柱牙印模的個別模托
 (C)製作牙冠、牙橋 (D)製作手術後人工齒排列模型
- 33 使用自聚式樹脂製作個別模托的先後順序，下列何者正確：①封閉齒列模型上的倒凹部分 ②付與模托的握把部 ③設定模托的外形線 ④模托的形態修正和研磨 ⑤付與印模材的設置空間 ⑥研究用模型上用自聚式的樹脂壓接
 (A)③→①→⑤→⑥→④→②
 (B)①→③→⑤→⑥→②→④
 (C)①→③→⑥→⑤→②→④
 (D)③→①→⑥→⑤→④→②

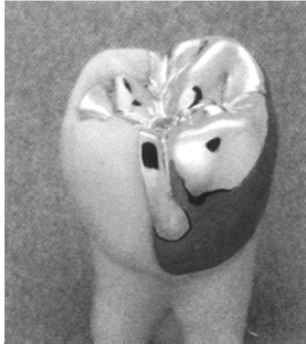
- 34 下列何者為固定義齒的製作中最廣泛應用的工作模型？
(A)固定式單齒模模型 (B)分割復位式模型
(C)可撤式單齒模模型 (D)個別式單齒模模型
- 35 進行分割復位式模型時的製作順序，由先至後排列？①植立根柱針 ②上石膏分離劑 ③灌模 ④整修支柱牙模型 ⑤削除多餘的模型基底部 ⑥整修工作模型基底部 ⑦分割支柱牙模型 ⑧塗抹表面硬化劑 ⑨上基底
(A)③→⑥→①→②→⑨→⑤→⑦→④→⑧
(B)③→⑥→①→⑧→⑨→⑤→⑦→④→②
(C)③→⑤→②→①→⑨→⑥→⑧→⑦→④
(D)③→⑤→①→②→⑨→⑥→⑦→④→⑧
- 36 關於蠟錐體技術進行單顎全口重建患者的築蠟過程，下列敘述何者正確？
(A)在前方咬合位置時，後牙應沒有接觸
(B)在咬頭嵌合位時，前後牙區必須有平均且同時的接觸
(C)決定咬頭位置及高度→形成咬合面嵴→形成軸面嵴→形成咬合面的溝和副嵴
(D)在鄰接面，以接觸點為中心只在上部、頰側、舌側各別形成楔隙
- 37 有關包埋材使用時的特性，下列敘述何者正確？
(A)磷酸鹽系包埋材可耐高溫，強度比石膏系包埋材高，故可用鐵環來包埋
(B)白矽土包埋材的加熱膨脹較石英包埋材大
(C)磷酸鹽系包埋材的滲透性、通氣性比石膏系包埋材佳
(D)包埋材須有適當的收縮，以補償金屬鑄造時尺寸和形態的變化
- 38 樹脂、金合金、陶瓷這三種材質依照沾附牙菌斑的容易程度來排順序，下列何者正確？（最容易＞居中＞最不容易）
(A)樹脂＞金合金＞陶瓷 (B)陶瓷＞金合金＞樹脂
(C)樹脂＞陶瓷＞金合金 (D)金合金＞陶瓷＞樹脂
- 39 有關牙科用瓷的敘述，下列何者正確？
(A)在牙科修復體中，瓷是最具優良的美觀性，但與牙肉組織的相容性不及貴金屬
(B)高溫烘烤瓷應用的溫度為 1100～1200℃
(C)染色用瓷一般為高溫烘烤瓷
(D)低溫烘烤瓷為了降低熔點，所以去除白瓷土加入助熔劑
- 40 有關牙科用瓷的敘述，下列何者正確？
(A)上釉烘烤後表面亮滑，但菌斑附著仍較明顯
(B)烘烤時的體積收縮率較大，收縮量因粉末粒度的配合，以堆築時的空隙率決定
(C)按照建議溫度執行烘烤，即使烘烤次數較多，亦不會影響瓷的機械性質
(D)與樹脂相比有良好的耐磨耗性，但其耐磨耗性仍比自然牙小
- 41 牙科用瓷為了提高瓷泥的密度就必須以填壓方式操作，以下有關填壓的敘述何者正確？
(A)可以提高烘烤後的陶瓷強度
(B)造成陶瓷中氣泡的混入，降低透明度
(C)過度填壓可以大幅減少烘烤收縮
(D)目前操作上，調刀法是一般最常用的方法
- 42 以下有關貴金屬合金進行燒瓷前的表面處理之敘述，何者正確？
(A)表面處理完的貴金屬合金表面越粗糙越好
(B)第一回加熱處理時，在 980～1040℃的真空中停留烘烤 15 分鐘
(C)噴砂時使用 200μm 的氧化鋁砂，效果會比使用 50μm 的氧化鋁砂還好
(D)第二回加熱處理的目的是放出鑄造體中的瓦斯，同時解放殘餘應力，使金屬均一化而保有均勻的強度

- 43 以下有關半貴金屬合金進行燒瓷前的表面處理之敘述，何者正確？
(A)含銅的合金會使陶瓷黃變
(B)半貴金屬合金其主成分是鉑
(C)加熱處理後需要將表面變黑的金屬層去除後再燒瓷
(D)一般使用碳鋼磨針作表面研削
- 44 以下有關非貴金屬合金進行燒瓷前的表面處理之敘述，何者正確？
(A)一般使用碳鋼磨針作表面研削
(B)加熱處理後不需要將表面變黑的金屬層去除即可再燒瓷
(C)用 50~100 μ m 的氧化鋁作噴砂處理
(D)發生界面多孔性時，以不透光瓷的烘烤溫度，在非真空下用 5 分鐘作加熱處理即可
- 45 進行比色時需注意的重點，下列何者正確？
(A)比色不超過 5 秒，以免視覺疲勞
(B)患者牙齒表面應維持乾淨，唇上之口紅則無所謂
(C)患者應避免穿著強烈色彩之外衣，補色者則無此限制
(D)比色之間眼睛可先輕閉，或是往色彩強烈、明度極高處移動數秒，讓補色現象消失
- 46 進行比色時需注意的重點，何者錯誤？
(A)以比色片與牙齒或牙齒修復物左右並排的方式進行比色
(B)以比色片與牙齒或牙齒修復物切端對切端的方式進行比色
(C)眼睛對 2° 的視角範圍內的色彩感覺最靈敏
(D)比色者位於患者前方約 25~30 cm 的明視距離為佳
- 47 下列何種鐸劑具最佳流動性？
(A)18K 金鐸劑 (B)白金鐸劑 (C)銀鐸劑 (D)銅鐸劑
- 48 下列何者不是金屬鐸接時用來限制鐸劑漫延的抗熔劑材料？
(A)硼酸鈉 (B)石墨 (C)氧化鐵 (D)二氧化鈦
- 49 依據布拉克氏分類法 (Black's classification)，下列何者屬於內側性及外側性合併的窩洞？
(A) I 級窩洞 (B) II 級窩洞 (C) III 級窩洞 (D) V 級窩洞
- 50 有關嵌體 (inlay)、冠蓋體 (onlay) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)應用在牙齒局部缺損部位
(B)邊緣適合性越高，越能保護齒質
(C)金屬嵌體、冠蓋體可運用在牙橋固位體
(D)陶瓷嵌體、冠蓋體製作時，直接在石膏工作模型上窩洞堆築陶瓷後烘烤
- 51 有關套冠 (jacket crown) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)因製作材料不同，分為瓷套冠、樹脂套冠
(B)可應用於牙橋固位體
(C)主要應用於重視美觀之前牙及小白齒
(D)瓷套冠使用鋁化瓷
- 52 有關鞍型橋體 (saddle type pontic) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)美學與舌感差
(B)黏膜面不易清潔，衛生差
(C)適用於可撤式牙橋
(D)屬於非自潔型橋體

- 53 有關牙橋固定性連接補綴物製作方法的敘述，下列何者錯誤？
(A)在強度方面，一體鑄造法較銲接法佳
(B)在耐蝕性，一體鑄造法較銲接法佳
(C)在耐蝕性，銲接法較熔接法佳
(D)在技師操作性，一體鑄造法較銲接法簡單
- 54 有關牙橋連接體設計的敘述，下列何者錯誤？
(A)連接體的寬度增加兩倍，強度增加兩倍
(B)連接體的厚度增加兩倍，強度增加八倍
(C)連接體的剖面型態，前牙：圓丸三角形型態；後牙：圓丸長方形型態
(D)連接體的底部理想外型為 V 字型
- 55 有關製作牙冠補綴物鄰接面接觸點的敘述，下列何者正確？
(A)前牙：鄰接面接觸點在唇舌方向偏唇側 1/3
(B)前牙：鄰接面接觸點在切緣齒頸方向靠近中 1/3
(C)後牙：鄰接面接觸點在頰舌方向偏頰側 1/3
(D)後牙：鄰接面接觸點在咬合齒頸方向靠近中 1/3
- 56 有關牙冠補綴物與牙周組織關係的敘述，下列何者錯誤？
(A)牙冠補綴物的邊緣可設定在破壞上皮附連（epithelial attachment）的位置
(B)牙冠補綴物的表面應精細研磨
(C)牙冠補綴物的豐隆過大，牙齦邊緣容易有食物停滯
(D)牙冠補綴物的豐隆不足，牙齦會過度刺激
- 57 有關口內不同種金屬間產生電流的現象（伽凡尼作用）之敘述，下列何者錯誤？
(A)腐蝕易發生在應力承載面
(B)腐蝕易發生在氧濃度較大區域
(C)腐蝕易發生金屬組織相異的結晶體周界
(D)當貴金屬與非貴金屬合金接觸時，非貴金屬合金側會失去電子而腐蝕
- 58 與根柱牙冠（post crown）相比較，下列何者不是在冠心製作體上覆蓋牙冠補綴物的優點？
(A)牙冠補綴物破壞時容易重新製作
(B)製作牙橋時，支柱牙間不易取得平行性
(C)可適當修正齒軸有利美觀
(D)牙冠補綴物重新製作時，造成牙根破折之危害較低
- 59 支柱牙模型（單齒模）與齒列模型一體成型的工作模型，屬於下列何種工作模型？
(A)固定式單齒模模型
(B)可撤式單齒模模型
(C)個別式單齒模模型
(D)分割復位式模型
- 60 有關牙冠補綴物製作時使用之印模材敘述，下列何者錯誤？
(A)瓊膠屬於可逆性印模材
(B)藻膠屬於不可逆性印模材
(C)瓊膠和藻膠屬於水凝膠印模材
(D)矽膠印模材親水性佳
- 61 下列何者不是燒瓷前金屬表面研削調整之目的？
(A)使金屬表面光滑細緻
(B)去除包埋材顆粒
(C)去除氧化物
(D)形態、厚度、表面狀態最終修正
- 62 金屬燒結陶瓷修復物之金屬與陶瓷間結合力，下列何者最重要？
(A)機械結合力
(B)凡得瓦力
(C)化學結合力
(D)壓縮應力

- 63 下列何者不是貴金屬系合金燒瓷前除氣（degassing）處理之主要目的？
(A)防止陶瓷燒結時產生變色，有利色調表現 (B)去除研磨時磨光材的殘渣
(C)釋放鑄造體中的殘餘應力 (D)釋放鑄造體中的瓦斯
- 64 有關陶瓷燒附金屬冠最後上釉步驟之敘述，下列何者錯誤？
(A)不用上釉粉，升溫至瓷表面玻璃化的方法稱為自動上釉法
(B)需要上釉粉後燒成的方法稱為人工上釉法
(C)人工上釉法燒成溫度較自動上釉法高
(D)上釉燒成時瓷爐不需抽真空
- 65 有關比色注意事項之敘述，下列何者錯誤？
(A)牙齒表面要乾燥，避免影響色澤
(B)牙齒表面要乾淨，避免影響色澤
(C)不可凝視牙齒過久，避免視覺疲勞
(D)比色者眼睛與患者牙齒、比色板相距約 25~30 cm
- 66 針對牙橋結構的描述，下列何者錯誤？
(A)缺牙部分補做的人工齒，稱為橋體（pontic）
(B)橋體與固位體間相連結的部分，稱為連結體（connector）
(C)針對缺牙區的鄰接牙齒，以牙冠製作的維持裝置，稱為固位體（retainer）
(D)橋體與固位體承受的咬合力會傳到支柱牙的牙冠，因此牙橋又稱為牙周膜負擔義齒（tooth borne denture）
- 67 下列何種支柱牙的邊緣形態因為適合性佳，常被應用在各類型牙冠補綴物的製作？
(A)斜面緣（bevel） (B)弧形緣（chamfer）
(C)肩台緣（shoulder） (D)刀緣形邊緣（knife-edge margin）
- 68 下列何種築蠟（wax up）方法，主要以構成牙冠部位分解築蠟成形，常用在形成機能性咬合面形態的場合？
(A)雕刻法（carving technique）
(B)浸漬法（dipping wax method）
(C)蠟錐體技術（wax cone technique）
(D)軟化壓接法（pattern forming technique by softened wax）
- 69 下列針對雷射熔接法（laser welding）的敘述何者正確？
(A)熔接過程容易造成局部氧化
(B)使用與母金組織成分相同的熔接金屬
(C)熔接過程中須連同母金作大範圍加熱
(D)均需要用銲接包埋材固定母金以提高精確度
- 70 金屬鍵結瓷的烤瓷程序中，那一個過程可以不必真空烘烤？
(A)上釉
(B)不透光瓷
(C)修正烘烤（燒成）
(D)不透光牙本質瓷
- 71 有關製作片狀鑲面（lamine veneer）過程中需要注意的事項，下列何者錯誤？
(A)只適合用於單冠製作
(B)通常需要使用耐火模型作為工作模型
(C)鄰接面需使用石膏模型鋸分割以利邊緣製作
(D)須使用矽膠印模材採超精密印模法取得鄰接面附近外形

- 72 製作陶瓷融合金屬冠時，非貴重金屬薄蓋冠表面須以多大顆粒（ μm ）的氧化鋁噴砂處理？
(A) 15~30 (B) 50~100 (C) 150~200 (D) 250~300
- 73 下列四種材料當中，何者對光的折射率最大？
(A) 石英 (B) 鑽石 (C) 氧化鋯 (D) 氧化鋁
- 74 針對全陶瓷冠燒結用瓷的選擇考量，下列敘述何者錯誤？
(A) 色調的表現
(B) 熱膨脹係數
(C) 依全陶瓷支架差異選擇瓷材
(D) 彈性係數（elastic modulus）相較，氧化鋯比氧化鋁高
- 75 製作全陶瓷冠用瓷時必須注意的事項，下列敘述何者正確？
(A) 各類瓷架使用的瓷材均可互通使用
(B) 全陶瓷支架在燒瓷時比金屬需要較少熱能
(C) 陶瓷支架與瓷材兩者的熱膨脹係數最好相同
(D) 瓷材的熱膨脹係數可以比陶瓷支架稍高一點較好
- 76 下圖屬於何種牙冠分類？



- (A) 3/4 冠 (B) 1/2 冠 (C) 7/8 冠 (D) 鄰接面半冠
- 77 下列何者不屬於全部鑲面牙冠？
(A) 全鑄造牙冠 (B) 片狀鑲面 (C) 套冠 (D) 根柱牙冠
- 78 有關局部鑲面牙冠的敘述，下列何者正確？
(A) 常應用於無髓齒
(B) 牙齒切削的量較少，故易於製作
(C) 可保留較多天然齒質
(D) 因涵蓋面積不夠，不適合應用在牙橋固位體
- 79 有關牙橋的敘述，下列何者正確？
(A) 戴入固定後要熟悉管理及清潔 (B) 戴入固定後，容易於口內修正
(C) 只要有缺牙區，必可進行牙橋製作 (D) 使用於前牙區時，易有發音問題
- 80 牙冠補綴物的輪廓外形對牙齒周邊軟組織的影響，下列敘述何者正確？
(A) 輪廓外形越大，越能保護周邊牙齦組織
(B) 咀嚼時，牙冠的輪廓外形並不影響食物的流向
(C) 牙冠的輪廓外形，必要的自淨作用加上適當刺激可以保持牙齦健康
(D) 輪廓外形越小，周邊牙齦組織越能接受食物按摩刺激，促進血液循環